

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2021年8月31日投资者关系活动记录表

编号：2021-08-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	银华基金管理股份有限公司：李晓星、杜宇、郭磊 信达证券股份有限公司：童秋涛
时间	16：00~17:00
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况介绍</p> <p>公司于1993年成立，至今已28年，战略方向明确，始终坚守主业，专注于线路板行业发展，从传统的PCB样板、小批量板拓展至以IC封装基板、半导体测试板业务为代表的半导体业务，通过自身的研发投入和积累实现产品和技术的升级。未来公司仍会专注于主业，以IC封装基板作为主要投资和扩产的方向。</p> <p style="text-align: center;">二、2021年上半年经营情况介绍</p> <p>上半年营收23.71亿元、同比增长15.83%；净利润2.85亿元、同比下滑24.24%，主要因为去年同期有2.26亿元股权转让的投资收益，基数较高；扣非后净利润2.87亿元，同比大幅增长103.15%，延续了较高的</p>

增长态势。

主要是公司整体的经营效率在进一步提升，盈利能力持续提升：毛利率 32.78%、净利率 12.29%，整体盈利能力从 2017 年以来处于持续提升的过程中。

期间费用率持续下降：销售费用率同比下降 1 个百分点，管理费用率同比下降 0.5 个百分点，财务费用率略微增长。对比同行，公司内部挖潜的空间仍然比较大，整体费用率还有进一步下降的空间，这也是公司一直推动的降本增效工作所坚持的方向。

IC 载板业务供需两旺，订单已经排产至今年年底。公司 2 万平方米/月产能除 2 月份受春节因素影响外，一直处于满产状态。上半年收入 2.95 亿元，同比增长 111.06%，毛利率 20.80%，同比提升了 11.55 个百分点。

半导体测试板业务有所下滑，主要是因为泽丰出表、以及扩产产能尚未释放；表现略落后于 PCB 和 IC 载板业务。

三、半导体业务的具体情况

半导体行业从去年开始表现出产销两旺的格局，收入利润持续增长，产业链高景气。IC 载板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，也受益于芯片产业链的高景气，目前订单能见度很高。2020 年全球 IC 载板行业规模 100 亿美金，增长 25%，Prismark 预测 2021 年全球 IC 载板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元、复合增长率 9.7%，届时 IC 载板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增长最确定的子行业。目前内资载板厂 2020 年规模 4 亿美金，市场占有率仅有 4%，而国内封测厂全球市场占有率 25%以上，国产配套率仅有 10%出头。中国 PCB 产能占全球比重 80%，内资 PCB 份额占比 50%以上，从设备到材料端的产业链配套非常完善，产能的全球转移是大的时代背景。未来国内晶圆和封测产能持续投放是未来增长的保证。公司 2012 年进入 IC 载板，时间长达 10 年，亏损时间长达 7、8 年，2019 年财务层面盈利，预计 2021 年实现经营目标，目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源。海外大客户的认证周期都是长达 2 年，三星认证的通过说明我们的体系、能力、技术都得到了认可，预计 2~3 年内产业链供需格局还是很好。

	<p>四、ABF 载板公司规划</p> <p>从目前看国内需求还没有起量，产能有限，首先需要解决晶圆短缺的问题，公司会积极跟进和关注产业趋势。</p> <p>五、半导体测试板介绍</p> <p>国内参与企业较少，公司是 2015 年通过收购美国 Harbor 和设立上海泽丰进入该行业，2020 年实现 5 亿元收入，在国内规模领先。</p> <p>台湾同行中华精测给岛内产业链配套，40~50 亿新台币收入，维持 55%以上毛利率，25%以上净利率，附加值高。半导体测试板有三类：探针卡做晶圆测试，负载板做封装后的芯片测试，老化板做封装后的老化测试。全球 200 亿元市场空间，经营管理模式类似 PCB 样板，高端定制化，多品种多批次小批量。</p> <p>2021 年上半年收入下滑是因为出售上海泽丰股权导致不再纳入合并报表，扣除该因素影响同比下滑 3.42%，主要原因是美国 Harbor 产能受限，广州兴森去年启动半导体测试板扩产，目前产线建设完成、产能尚未释放，目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并且能为美国 Harbor 提供产能支持。</p>
附件清单 (如有)	
日期	8 月 31 日